

# 光通信器件封装芯片粘接导电银胶(替代MD-1500)

产品名称	光通信器件封装芯片粘接导电银胶(替代MD-1500)
公司名称	上海金泰诺材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金泰诺 型号:替代MD-1500 产地:中国
公司地址	上海市奉贤区金海公路4808弄30号408室(注册地址)
联系电话	13817204081

## 产品详情

案例名称：光通信器件封装芯片粘接导电银胶(替代MD-1500)

应用点: 芯片粘接

要求：

替代日本丸内MD-1500，对粘片粘贴强度好，导电性能好，胶水使用的时间长

应用点图片：

解决方案：国产优质导电银胶

